

LCP 日本宝理 S135 BK010P连接器专用LCP塑胶原料欢迎来电

产品名称	LCP 日本宝理 S135 BK010P连接器专用LCP塑胶原料欢迎来电
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;

塑胶原料大部分可循环使用,但由于翻用塑料(水口料)比一般原料要脆,所以只可混合新料(原料)一起使用,比例最大不可超过25%为合适,应以顾客要求标准为原则.各种类型的塑料料因所需的熔点不同,所受的注塑压力不同,生产中一定不可相混淆.

通用塑料这类塑料时一类用途十分广泛的塑料,它产量大,约占塑料总产量的四分之三,价格低,大量用来制作受力不大的日用品,如电视机外壳、电话机外壳、塑料盆、塑料桶等。与人们的关系十分密切,成为塑料工业的重要支柱。常用的通用塑料有PE、PVC、PS、PP、PF、UF、MF等。

POM加工前可不用干燥,在加工过程中烘90度左右,对产品尺寸的稳定性有好处。

电气绝缘性能好 大多数塑料具有优良的电绝缘性,这是因为高分子内部没有自由移动的电子和离子。所以不具备导电能力,但是由于添加剂的加入。使得塑胶原料的电绝缘性能产生了一些变化;大多数塑胶原料在低频、低压时绝缘性很好,少数塑胶原料即使在高频、高压下也有良好的绝缘性,因此,塑胶原料被广泛用于电子、电气、通讯、仪器等领域中。

一般热致性液晶聚合物具有较好的流动性,易加工成型。其成型产品具有液晶聚合物特有的皮芯结构,树脂本身具有纤维性质,在熔融状态下有高度的取向,故可起到纤维增强的效果。这也是液晶聚合物引人注目的特点。

塑胶原料:是由高分子合成树脂(聚合物)为主要成份渗入各种辅助料或某些具有特定用途的添加剂,在特定温度,压力下具有可塑性和流动性,可被模塑成一定形状,且在一定条件下保持形状不变的材料。

液晶又可分为溶致液晶聚合物和热致液晶聚合物。前者在溶剂中呈液晶态,后者因温度变化而呈液晶

态。

绝缘材料：PEEK因具有优良的电气性能，在高温、高湿等恶劣条件下，聚醚醚酮的绝缘性能仍能保持，是理想的电绝缘材料，特别是在半导体工业中得到广泛应用。

在制作连接器产品的时候，总会有需要用到塑料材质的时候，连接器将介绍连接器生产时常用的塑料材质有哪些？这些材质又需要满足汽车连接器产品的哪些要求呢？就制作材质来说，连接器常用到的塑料原材料主要有PBT、66、6T、9T、LCP等，而这些材料在质量、耐高温性能以及价格上都是有区别的，当然了，这些区别也会体现在连接器价格之上。

塑胶原料按照合成树脂的分子结构分主要有热塑性及热固性塑胶之分：对于热塑性塑胶指反复加热仍有可塑性的塑胶：主要有PE/PP/PVC/PS/ABS/PMMA/POM/PC/PA等常用原料。热固性塑胶主要指加热硬化的合成树脂制得的得塑胶，像一些酚醛塑胶及氨基塑胶。

- 1、光学镜头、光学播音器、多边镜、角膜板用保护膜；
- 2、DVD碟片、保护膜、大型显示器、背光导光板、小型显示器前光导光板；
- 3、光学半导体、光学薄膜、医疗器材、汽车配件；
- 4、镜片材料、高像素镜头；
- 5、光纤和分析化学仪器用池/槽。

聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。

塑胶对电、热、声具有良好的绝缘性:电绝缘性，耐电弧性，保温，隔声，吸音，吸振，消声性能卓越。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材

料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。